

TURBO X

T62 蜂窝模组

突破性的无线性能



TurboX T62 系列蜂窝模组集成了 Qualcomm® Snapdragon™ SDX62 5G Modem-RF 系统，可支持 5G Sub-6 GHz 及能与 4G/3G 网络兼容的 SA、NSA 模式。

T62 系列模组 SDX62 芯片组集成了 4 纳米工艺，性能优越，电源效率高，支持 3GPP Release 16。此款模组可帮助 ODM/OEM 厂商向全球市场轻松推出快速连接的产品，并能完美适用于 CPE/MIFI/工业路由器、任务关键型应用领域（救护车、安保、机器人、AR/VR、直播等）及远程医疗（外科手术、诊断、援助等）设备。

应用领域



CPE/工业路由器



工业控制



自动导引车



网络直播

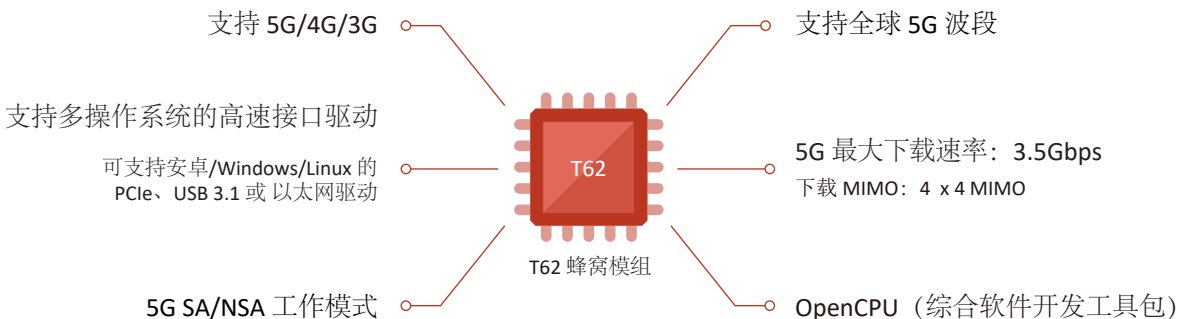


VR/AR



远程医疗

产品特性



T62G-EA 规格

规格	类别	T62G-EA
SDX62 芯片组	CPU	Arm Cortex-A7 (1.8 GHz)
	DSP	Qualcomm® Hexagon™ DSP 处理器 (1.5 GHz)
	电源管理	PMX65
	射频接收器	SDR735
内存	DRAM/NAND	4Gb DDR4 + 4Gb NAND
空中接口	5G NR	Sub-6GHz: n1,n3, n5, n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41, n77, n78, n79
	LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B32/B38/B40/B41/B42/B43
	WCDMA	B1/B5/B6/B8/B9/B19
数据传输速率	最大下载速率	5G NR: 3.5Gbps DL 4x4 MIMO
	最大上传速率	5G NR: 1.1Gbps 2x2 MIMO
连接性能 及外围接口	BLSP	4xBLSP 支持 UART、SPI、I2S
	天线类型	8x sub-6GHz
	UIM	2x USIM
	串行总线	1x Gen3 2-lane
	I2S	2x I2S/PCM
	USB	1x USB 3.1
封装类型	LGA	LGA : 42.5mm x 45.5mm x2.6mm
认证	Regulatory&Carrier	CCC"/SRRC"/KC "/JATE "/TELEC "/CE"/GCF"/LGU"+ /KT"/SKT"/NTT DOCOMO"/Softbank"/KDDI"
重量		11.05 ± 0.2g (待定)
电源	电压范围	3.0~4.35V, 典型值: 3.8V
温度范围	工作温度	-30°C ~ +75°C
	存储温度	-40°C ~ +85°C
软件	操作系统	Linux, 可兼容 Windows/Ubuntu/Android 主系统

" 规划中

